

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2017-039

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于收到02专项2017年度项目立项批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于 02 专项 2017 年度项目立项批复的通知》（ZX02[2017]010 号），公司申报的“国产中道工艺高端封测装备与材料量产应用工程”（课题编号：2017ZX02518001）获得国家科技重大专项—02 专项 2017 年度项目立项审批。

该项目周期为 2017 年—2019 年，项目补助方式为事前立项、事后补助（预拨启动经费），中央财政资金补助预算总额为人民币 3,063.73 万元，其中 2017 年度预算为人民币 919.12 万元，项目验收后补助预算最高限额为人民币 2,144.61 万元。

根据项目立项指南，该项目目标为针对汽车电子及智能制造等产业高速发展对于智能传感器高性能、高可靠性、高集成度、低成本等需求，突破现有晶圆级封装及传统封装（如金属封装、陶瓷封装等）的局限性，开发新一代智能传感器高可靠性晶圆级封装工艺。项目通过采用创新封装结构和工艺，大幅度提高智能传感与控制产品的性价比，达到汽车及工业级可靠性要求。

项目将以汽车电子及智能制造需求为牵引，以国产半导体制造装备及材料在消费类先进封装领域的产业化成果为基础，进一步升级国产关键装备及材料，以实现其在汽车电子、智能制造等高端领域的大规模产业化应用，为推进中国版的工业4.0打下坚实基础。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2017年9月22日